

## 天津德高化成新材料股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确及完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得中华人民共和国知识产权局颁发的《发明专利证书》1项，具体信息如下：

### 一、基本信息

发明名称：芯片级封装的倒装LED白光芯片的制备方法

发明人：谭晓华；韩颖；冯亚凯

专利号：ZL 2015 1 0245273.7

专利申请日：2015年05月14日

专利权人：天津德高化成新材料股份有限公司

授权公告日：2017年12月12日

专利权期限：二十年

### 二、对公司的影响

公司获得此项发明专利，充分体现了公司的自主研发及创新能力，有利于公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力，提供公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。

### 三、备查文件目录

《发明专利证书》（证书号第 2735696 号）

特此公告

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日